

01 智慧財產及商業法院行政判決

02 114年度行專訴字第42號

03 民國115年1月22日辯論終結

04 原 告 裕晨科技股份有限公司

05 代 表 人 林秋郎

06 訴訟代理人 張東揚律師

07 賴蘇民律師

08 複 代 理 人 孫德沛律師

09 顏漢彰律師

10 輔 佐 人 廖子謙

11 被 告 經濟部智慧財產局

12 代 表 人 廖承威

13 訴訟代理人 林麗芬

14 參 加 人 楊季仁

15 訴訟代理人 呂紹璋律師

16 林尚儒專利師

17 上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國11
18 4年7月2日經法字第11417302680號訴願決定，提起行政訴訟，並
19 經本院依職權命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

20 主 文

21 一、原告之訴駁回。

22 二、訴訟費用由原告負擔。

23 事實及理由

24 一、爭訟概要：

25 原告前於民國109年4月27日以「散熱裝置」向被告申請新型
26 專利，申請專利範圍共8項，經被告進行形式審查後於同年5
27 月5日准予註冊為第M598743號專利（下稱系爭專利）。嗣參
28 加人以系爭專利有違核准時專利法第120條準用第22條第2項
29 規定，不符新型專利要件，提起舉發。經被告以113年11月1
30 2日(113)智專議(三)05078字第0000000000號專利舉發審定
31 書為「請求項1至8舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處

01 分)。原告不服，提起訴願，經經濟部於114年6月23日辦理
02 言詞辯論後，而以同年7月2日經法字第00000000000號訴願
03 決定（下稱訴願決定）駁回，原告因而向本院提起訴訟。又
04 本院認本件判決結果，倘撤銷原處分及訴願決定將影響參加
05 人之權利或法律上利益，爰依職權命參加人獨立參加本件訴
06 訟。

07 二、原告主張及聲明：

08 (一)證據1之影片為關於筆記型電腦之應用，其散熱器材質一般
09 為銅；證據2之影片、證據3之網頁均為關於桌上型電腦之散
10 熱，一般使用採鍍鎳銅材質之集成式散熱器（IHS），主要
11 目的係鍍鎳材質可增加焊料和集成式散熱器之焊接性以及避
12 免氧化問題，由於筆記型電腦並無前揭需求，且基於「筆電
13 」與「桌機」技術領域之差異，所屬技術領域具通常知識者
14 並無動機將筆記型電腦中之銅散熱器置換為桌上型電腦鍍鎳
15 的集成式散熱器之動機，又受限於筆電空間上限制，亦無法
16 在證據1中應用結構不同、體積較大且散熱效果較差的集成
17 式散熱器。再者，在銅質散熱器鍍上鎳層會增加成本負擔，
18 且筆電屬於成熟產業，若銅質散熱器可以使用，品牌製造商
19 並不會採取鍍鎳銅之作法，益徵通常知識者並沒有將證據2
20 、3的教示應用來結合證據1之動機。

21 (二)證據1、2、3之組合並不足以證明系爭專利不具進步性：

22 1.系爭專利請求項2之「擋板」係以站立方式設置而具有一定
23 高度或厚度，並界定出立體的内部空間，惟證據1所揭露的
24 「保護膠」係平面之膠帶，要不是緊密貼合基板，頂多只能
25 與基板所形成幾乎無厚度之夾縫，不足以構成擋止面或形成
26 封閉空間，並無法達成抑止液態金屬流動以保護主機板及其
27 他電子元件之功效，顯見系爭專利之「擋板」有別於證據1
28 之「保護膠」，且該有利功效為所屬技術領域中具通常知識
29 者在參酌證據1至3後仍無法預期者，故未被證據1至3所揭露
30 。又系爭專利請求項6明確界定擋板13係立設於絕緣層14旁

01 ，而證據1的保護膠遮覆包含三防漆在內的電子印刷板，並
02 未位於三防漆的外側或旁側，並未揭露有關擋板與絕緣層之
03 相對位置，且如前所述，系爭專利請求項6的擋板的設置方
04 式為立設，空間形態上與證據1不同，具有證據1至3不具備
05 之功效，應具進步性。

06 2.在系爭專利申請前的設計偏見（例如證據1）都是透過控制
07 液態金屬層的使用量來改善液態金屬溢流的問題，但無法徹
08 底解決，系爭專利請求項2、6為首見且創新地透過立設擋板
09 之立體結構，徹底地解決液態金屬的溢流問題，實屬一種無
10 法輕易思及且非顯而易見之創新技術手段，且系爭專利請求
11 項2、6可顯著增加液態金屬的使用量，明顯提高散熱能力，
12 具備有利功效，當具有進步性。

13 3.又由證據1的保護膠與上方的散熱器相距甚遠而呈開放狀，
14 而系爭專利的擋板因為立設在下方的絕緣層及上方的防腐蝕
15 金屬層間並形成具體的封閉空間，液態金屬無法由此封閉空
16 間中溢出，證據1的開放狀結構則無法阻攔液態金屬的外溢
17 ，足見系爭專利請求項7之具體結構與證據1不同。是以，系
18 爭專利請求項2、6、7均具有證據1至3所不具備的有利功效
19 ，應具有進步性，其所依附其他請求項亦同樣具有進步性。

20 4.另依系爭專利說明書【0009】段記載可知，擋板13其「擋」
21 字所代表的功能「阻擋」係為阻擋請求項1中具有流動性的
22 液態金屬層流淌至基板21上。原處分未參酌系爭專利說明書
23 內容且忽略擋板具有阻擋之意涵，在解釋請求項時有未以請
24 求項記載文字為基礎之違法。由原告為清楚呈現系爭專利設
25 置擋板與證據1使用保護膠帶之區別而進行實驗後，依其實
26 驗結果可以證明，證據1的保護膠帶僅是用來保護所貼設區
27 域下方的電容不受刮傷，並不具有擋阻液態金屬流動之功效
28 ，而系爭專利所立設之擋板則可擋止液態金屬流動以避免其
29 向外溢流，縱使在筆電或電子產品轉換方向並震動的情況下
30 仍能產生作用。被告未充分調查系爭專利與各證據所能實際

01 達成的功效，並將立設之擋板與平貼之膠帶視為相同，自有
02 違反論理及經驗法則之違法。

03 (三)聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

04 三、被告答辯及聲明：

05 (一)系爭專利請求項1之一種散熱裝置，適用於一發熱源，該散
06 熱裝置包含：一散熱片，包括一面向該發熱源的片體；及一
07 液態金屬層，設置於該發熱源與該散熱片之間的技術特徵，
08 已為證據1所揭露。又系爭專利請求項1之一鍍在該散熱片體
09 上的抗腐蝕金屬層，且與液態金屬貼合的技術特徵，因證據
10 3為液態金屬如何影響銅、鎳和鋁（腐蝕測試）之網頁資料
11 ，以Conductonaut液態金屬與鋁散熱器、鍍鎳IHS（整合式
12 散熱器）及銅散熱器的相互作用之測試，其中鍍鎳IHS腐蝕
13 測試使用鍍鎳銅（Nickel-plated copper）金屬，鍍鎳銅之
14 散熱器可以與Conductonaut液態金屬一起使用，且證據3網
15 頁最後結論揭示「使用液態金屬對於鍍鎳IHS，液態金屬鎳
16 成分與鎳結合，不存在腐蝕和性能問題」，故證據3已教示
17 具有抗腐蝕功能之金屬層，揭露系爭專利請求項1之一鍍在
18 該片體上的抗腐蝕金屬層，且與液態金屬貼合的技術特徵。
19 此外，證據1、2、3間具有散熱技術領域之關連性，且均具
20 有以液態金屬散熱之作用或功能上共通性，依證據2、3抗腐
21 蝕之液態金屬教示，系爭專利所屬技術領域中具通常知識者
22 自有動機將證據2、3抗腐蝕之液態金屬運用於證據1之液態
23 金屬貼合該散熱片之抗腐蝕金屬層，係屬能輕易完成系爭專
24 利請求項1之創作，並不具進步性。

25 (二)證據1影片中之保護膠設於基板且圍繞電子元件，保護膠設
26 置位置與系爭專利之擋板相同，具有阻止液態金屬溢流功能
27 當可預期，且彼此細微結構上之差異乃系爭專利所屬技術領
28 域中具有通常知識者之簡單修飾。又系爭專利請求項2、7均
29 未進一步詳細界定擋板的結構或與其他元件之配置關係，自
30 無法引入原告所稱「擋板立設在下方絕緣層及上方防腐蝕金
31 屬層間並形成具體封閉空間」之技術特徵。另由證據1之保

01 護膠位置同樣位於三防漆旁圍繞電子元件，已揭露系爭專利
02 請求項6之「散熱裝置還包含一設置於該基板上的絕緣層，
03 及一立設於該絕緣層旁且圍繞該電子元件的擋板」之附屬技
04 術特徵。故原告主張系爭專利請求項2、6、7具有進步性，
05 並不可採。

06 (三)聲明：原告之訴駁回。

07 四、參加人答辯及聲明：

08 (一)由證據1可知其處理器為發熱源，在其上方塗抹一層液態金
09 屬，證據1之銅揭露散熱片，亦揭露於銅塗滿一層液態金屬
10 ，故系爭專利請求項1之「液態金屬層，設置於該發熱源與
11 該散熱片之間」技術已被證據1充分揭露。又證據1雖未提及
12 請求項1中關於抗腐蝕金屬層之技術特徵，但證據2之影片已
13 明顯揭露請求項1關於抗腐蝕金屬層之技術特徵，另與證據3
14 之液態金屬如何影響銅、鎳和鋁（腐蝕試驗）之部落格文章
15 相互參照，證據3之標題即已載明為腐蝕測試，全文亦直指
16 銅需要鍍鎳方有抗腐蝕之效果。所謂抗腐蝕金屬層與液態金
17 屬層均為功能性用語，其中液態金屬層主要為散熱功能，而
18 抗腐蝕金屬層主要是具抗腐蝕功能之金屬即可，實際運作上
19 並無限制或限定液態金屬層/抗腐蝕金屬層能夠同時扮演其
20 餘功能之金屬（例如，證據3之液體金屬層同時具有散熱且
21 抗腐蝕功能，不會使得鍍鎳的散熱片受到腐蝕）。再者，證
22 據1至3為相同或具關連性之技術領域，且均為解決相同之散
23 熱問題，包含實質相同之功能或作用，所屬技術領域中具通
24 常知識者自有動機結合證據1至3之技術內容，並無疑義。

25 (二)系爭專利中提及「液態金屬」與「擋板」均屬於上位概念，
26 並未進一步具體限定液態金屬之種類及擋板之材料、結構等
27 下位技術特徵。證據1所載「保護膠帶」係對其「保護」上
28 位概念的界定，核與系爭專利所定義「擋板」之核心功能「
29 阻擋液態金屬溢流」顯屬於「保護」之核心內涵與具體體現
30 ，二者具有包含關係，此為文義解釋與技術常識之當然結果

01 ，足以使本領域通常知識者理解並實現該項功能。至於原告
02 質疑之「擋牆高度」問題，實屬技術實現細節範疇，通過增
03 加保護膠帶之單層厚度或多層疊加方式即可達到相應之阻擋
04 高度要求，該等實現方式簡單易行，亦屬本領域之通常知識
05 範圍，是以證據1之保護膠帶與系爭專利所稱之「擋板」相
06 對應且功能完全一致。原告以其未在系爭專利說明書中提及
07 之下位具體技術特徵不當引入解釋其專利範圍，使其專利範
08 圍較諸文義上不同，以避開證據之比對並不可採。

09 (三)聲明：原告之訴駁回。

10 五、本件爭點：證據1、2、3之組合是否足以證明系爭專利請求
11 項1至8不具進步性？

12 六、本院判斷：

13 (一)系爭專利申請日為109年4月27日，於同年5月5日形式審查後
14 准予專利，並於同年7月21日公告。參加人於112年6月8日提
15 起舉發，依專利法第119條第3項規定，系爭專利有無撤銷原
16 因，應依核准審定時之108年5月1日修正公布、同年11月1日
17 施行之專利法為斷（下稱核准時專利法）。又核准時專利法
18 第120條準用同法第22條第2項規定，新型為其所屬技術領域
19 中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不
20 得取得新型專利。

21 (二)系爭專利之技術內容、主要圖式及申請專利範圍詳如附表1
22 所示。另舉發之證據1至3公告日、公開日皆早於系爭專利申
23 請日，均可作為系爭專利之先前技術（相關技術內容及網頁
24 截圖如附表2）。

25 (三)證據1、2、3之組合足以證明系爭專利請求項1至8不具進步
26 性：

27 1.系爭專利請求項1與證據1之比對：

28 證據1揭露液態金屬矽脂應用於筆記型電腦CPU、GPU之散熱
29 模組，將該液態金屬矽脂分別塗佈於CPU、GPU表面（截圖一
30 02:23），及與散熱模組對應表面（截圖三02:44）之技術內
31 容。依其所揭示CPU、GPU與系爭專利請求項1之發熱源相當

01 、散熱模組，與系爭專利請求項1之散熱片相當、液態金屬
02 矽脂與系爭專利請求項1之液態金屬層相當，故證據1已揭露
03 系爭專利請求項1之「一種散熱裝置，適用於一發熱源，該
04 散熱裝置包含：」、「一散熱片，包括一面向該發熱源的片
05 體」、「一液態金屬層，設置於該發熱源與該散熱片之間」
06 之技術內容，而未揭示「一鍍在該片體上的抗腐蝕金屬層」
07 及「一液態金屬層，貼合該散熱片之抗腐蝕金屬層」之技術
08 特徵。

09 **2.系爭專利請求項1與證據2、3之比對：**

10 證據2、3係揭露液態金屬應用於銅、鍍鎳銅和鋁之比較，其
11 中該液態金屬應用於鍍鎳IHS（整合散熱片）及銅散熱器，
12 其中鍍鎳IHS腐蝕測試即為鍍鎳銅金屬表面之技術內容。因
13 證據2、3之鍍鎳IHS（整合式散熱片）之金屬表面與系爭專
14 利請求項1之抗腐蝕金屬層之技術特徵相當，該鍍鎳IHS（整
15 合式散熱片）與液態金屬層結合且不生腐蝕反應，故證據2
16 、3已揭示證據1所未揭示之系爭專利請求項1「一鍍在該片
17 體上的抗腐蝕金屬層」及該液態金屬層「貼合該散熱片之抗
18 腐蝕金屬層」之技術內容。

19 **3.證據1與證據2、3之間具有結合動機，足以證明系爭專利請**
20 **求項1不具進步性：**

21 證據1與證據2、3均為應用於電腦散熱之測試影片或公開網
22 頁資料，彼此於電腦散熱之技術領域上具有關聯性，證據1
23 之液態金屬矽脂塗佈於CPU、GPU與相應散熱模組表面，以及
24 證據2、3之液態金屬塗佈於CPU、GPU和遊戲機搭配鍍鎳IHS
25 （整合式散熱片）之散熱器的冷卻使用，彼此於作用、功能
26 上亦具有共通性。參以證據3之網頁資料結論已明白教示「
27 液態金屬與鍍鎳IHS，是鍍鎳層的話液態金屬就可以安全使
28 用，液態金屬鎳成分與鎳能夠兼容，不會引發腐蝕和性能問
29 題」，則所屬技術領域中具有通常知識者為解決當使用液態
30 金屬作為散熱時可能造成金屬表面腐蝕之問題，自具有合理
31 動機將證據2、3具有抗腐蝕之鍍鎳IHS（整合式散熱片）之

01 鍍鎳銅金屬表面層應用至證據1之散熱模組與CPU之接觸面，
02 而能輕易完成系爭專利請求項1之創作，且系爭專利亦未產
03 生無法預期之功效，故證據1、2、3之組合足以證明系爭專
04 利請求項1不具進步性。

05 4.系爭專利請求項2不具進步性：

06 (1)系爭專利請求項2為直接依附於請求項1的附屬項，包含請
07 求項1全部技術特徵，如前所述，證據1、2、3之組合足以
08 證明系爭專利請求項1不具進步性。又系爭專利請求項2之
09 附屬技術特徵為「該發熱源包含一基板，及一設置於該基
10 板上的電子元件，其中，該散熱裝置還包含一立設於該基
11 板且圍繞該電子元件的擋板，該液態金屬層設置於該電子
12 元件與該散熱片之間。」。

13 (2)證據1之影片截圖四（時間戳記02:06）揭示該發熱源包含
14 一基板及基板上之電子元件之技術內容；證據1之影片截
15 圖五（時間戳記02:38）揭示該電子元件環設黏貼一保護
16 膠，該液態金屬層設置於電子元件與散熱片間之技術內容
17 ，已揭示系爭專利請求項2之附屬技術特徵，則所屬技術
18 領域中具有通常知識者依證據1、2、3之組合即可輕易完
19 成系爭專利請求項2之創作，依證據1、2、3之組合亦足以
20 證明系爭專利請求項2不具進步性。

21 (3)至原告雖主張系爭專利請求項2之「一立設於該基板且圍
22 繞該電子元件的擋板」，係讓液態金屬向外流動時會被一
23 定高度、厚度之「擋板」形成立體內部空間所擋止，該等
24 液態金屬收容於擋板之內部空間，防止液態金屬外流，具
25 備有利功效，惟證據1之保護膠非為對應液態金屬所設置
26 ，不具有厚度，不足以構成擋止面或封閉空間，未有防止
27 液態金屬流動防護之功效云云。然查，依證據1之影片截
28 圖五（時間戳記02:38）已揭示該保護膠具有一定厚度，
29 且該保護膠環繞該電子元件形成一立體內部空間之技術內
30 容，即具有擋止之功能；雖證據1並未直接揭示該保護膠

01 可擋止金屬液體流動之技術特徵，惟該保護膠係設於基板
02 與散熱片間，當基板與散熱片抵接組設自當具有密合效果
03 ，即具有系爭專利請求項2之擋板防止液體漏出及密合相
04 同之功效，所屬技術領域中具有通常知識者即可輕易思及
05 證據1之保護膠可抑制原廠散熱膏流動範圍，此與系爭專
06 利之「擋板」限定該金屬液體流動範圍避免造成元件短路
07 或腐蝕等情形即屬相當，故原告上揭主張自不足採。

08 5.系爭專利請求項3不具進步性：

09 (1)系爭專利請求項3為直接依附於請求項2之附屬項，包含請
10 求項2全部技術特徵，如前所述，證據1、2、3之組合足以
11 證明系爭專利請求項2不具進步性。又系爭專利請求項3之
12 附屬技術特徵為「該發熱源還包含複數設置於該基板上且
13 圍繞該電子元件的電子部件，其中，該散熱裝置還包含一
14 設置於該基板上且包覆該等電子部件的絕緣層。」。

15 (2)證據1之影片截圖四（時間戳記02:06）主持人說明「顯卡
16 上這些小電容同樣也要塗上三防漆」；證據1揭示設置於
17 顯卡之電容相當於系爭專利設置於基板之電子部件之技術
18 特徵，而於該等電容塗佈三防漆，即相當於設置於該基板
19 上且包覆該等電子部件的絕緣層之技術特徵，故已揭示系
20 爭專利請求項3之附屬技術特徵，則所屬技術領域中具有
21 通常知識者依證據1、2、3之組合即可輕易完成系爭專利
22 請求項3之創作，依證據1、2、3之組合亦足以證明系爭專
23 利請求項3不具進步性。

24 6.系爭專利請求項4不具進步性：

25 (1)系爭專利請求項4為直接依附於請求項1之附屬項，包含請
26 求項1全部技術特徵，如前所述，證據1、2、3之組合足以
27 證明系爭專利請求項1不具進步性。又系爭專利請求項4之
28 附屬技術特徵為「該發熱源包含一基板，及一設置於該基
29 板上的電子元件，其中，該散熱裝置還包含一設置於該基
30 板上且圍繞該電子元件的絕緣層，該液態金屬層設置於該
31 電子元件與該散熱片之間。」。

01 (2)證據1之影片截圖四(時間戳記02:06)主持人說明「顯卡
02 上這些小電容同樣也要塗上三防漆」；證據1揭示顯卡包
03 含基板及小電容，即相當系爭專利請求項4之發熱源包含
04 基板及電子元件之技術特徵；證據1揭示該基板上塗佈三
05 防漆，即相當系爭專利請求項4設置於該基板上且圍繞該
06 電子元件的絕緣層之技術特徵；證據1影片時間戳記2分28
07 秒揭示液態金屬設置於電子元件，即相當系爭專利請求項
08 4該液態金屬層設置於該電子元件與該散熱片間之技術特
09 徵，故證據1已揭示系爭專利請求項4之附屬技術特徵，則
10 所屬技術領域中具有通常知識者依證據1、2、3之組合即
11 可輕易完成系爭專利請求項4之創作，依證據1、2、3之組
12 合亦足以證明系爭專利請求項4不具進步性。

13 7.系爭專利請求項5不具進步性：

14 (1)系爭專利請求項5為直接依附於請求項4之附屬項，包含請
15 求項4全部技術特徵，如前所述，證據1、2、3之組合足以
16 證明系爭專利請求項4不具進步性。又系爭專利請求項5之
17 附屬技術特徵為「該發熱源還包含複數設置於該基板上且
18 圍繞該電子元件的電子部件，該等電子部件是被該絕緣層
19 所包覆。」。

20 (2)證據1之影片截圖四(時間戳記02:06)主持人說明「顯卡
21 上這些小電容同樣也要塗上三防漆」；證據1揭示小電容
22 、三防漆，即相當系爭專利請求項5之電子部件及絕緣層
23 之技術特徵，故證據1已揭示系爭專利請求項5之附屬技術
24 特徵，則所屬技術領域中具有通常知識者依證據1、2、3
25 之組合即可輕易完成系爭專利請求項5之創作，依證據1、
26 2、3之組合亦足以證明系爭專利請求項5不具進步性。

27 8.系爭專利請求項6不具進步性：

28 (1)系爭專利請求項6為直接依附於請求項1之附屬項，包含請
29 求項1全部技術特徵，如前所述，證據1、2、3之組合足以
30 證明系爭專利請求項1不具進步性。又系爭專利請求項6之
31 附屬技術特徵為「該發熱源包含一基板，及一設置於該基

01 板上的電子元件，其中，該散熱裝置還包含一設置於該基
02 板上的絕緣層，及一立設於該絕緣層旁且圍繞該電子元件
03 的擋板，該液態金屬層設置於該電子元件與該散熱片之間
04 。

05 (2)證據1之影片截圖四（時間戳記02:06）揭示該顯卡包含基
06 板及電容並塗佈三防漆之技術內容，即相當系爭專利請求
07 項6之發熱源包含基板、電子元件及絕緣層之技術特徵；
08 又證據1之影片截圖五（時間戳記02:38）揭示該保護膠設
09 於基板且圍繞電子元件之技術特徵，即相當系爭專利請求
10 項6之一立設於該絕緣層旁且圍繞該電子元件的擋板之技
11 術特徵；又證據1之影片截圖（本院卷第269頁，時間戳記
12 約2:28）揭示液態金屬設置於電子元件，即相當系爭專利
13 請求項6之該液態金屬層設置於該電子元件與該散熱片間
14 之技術特徵，故證據1已揭示系爭專利請求項6之附屬技術
15 特徵，則所屬技術領域中具有通常知識者依證據1、2、3
16 之組合即可輕易完成系爭專利請求項6之創作，依證據1、
17 2、3之組合亦足以證明系爭專利請求項6不具進步性。

18 9.系爭專利請求項7：

19 (1)系爭專利請求項7為直接依附於請求項1之附屬項，包含請
20 求項1全部技術特徵，如前所述，證據1、2、3之組合足以
21 證明系爭專利請求項1不具進步性。又系爭專利請求項7之
22 附屬技術特徵為「該發熱源包含一基板，及一設置於該基
23 板上的電子元件，其中，該散熱裝置還包含一設置於該基
24 板上的絕緣層，及一立設於該絕緣層上的擋板，該液態金
25 屬層設置於該電子元件與該散熱片之間。」。

26 (2)證據1之影片截圖四（時間戳記02:06）揭示該顯卡包含基
27 板及電容並塗佈三防漆之技術內容，即相當系爭專利請求
28 項6之發熱源包含基板、電子元件及絕緣層之技術特徵；
29 又證據1之影片截圖五（時間戳記02:38）揭示該保護膠設
30 於基板上之技術特徵，即相當系爭專利請求項7之一立設
31 於該絕緣層上的擋板之技術特徵；又證據1之影片截圖（

01 本院卷第269頁，時間戳記約2:28) 揭示液態金屬設置於
02 電子元件，即相當系爭專利請求項7之該液態金屬層設置
03 於該電子元件與該散熱片間之技術特徵，故證據1已揭示
04 系爭專利請求項7之附屬技術特徵，則所屬技術領域中具有
05 通常知識者依證據1、2、3之組合即可輕易完成系爭專利
06 請求項7之創作，依證據1、2、3之組合亦足以證明系爭
07 專利請求項7不具進步性。

08 10.系爭專利請求項8不具進步性：

09 (1)系爭專利請求項8為直接依附於請求項1之附屬項，包含請
10 求項1全部技術特徵，如前所述，證據1、2、3之組合足以
11 證明系爭專利請求項1不具進步性。又系爭專利請求項8之
12 附屬技術特徵為「其中，該抗腐蝕金屬層為鎳。」。

13 (2)證據2之影片截圖二(時間戳記00:31)揭示該液態金屬應
14 用於證據3揭示CPU、GPU和遊戲機的冷卻，可與銅或鍍鎳
15 表面接觸的散熱器搭配使用之技術內容；又證據3之網頁
16 資料揭露該液態金屬可應用於鍍鎳IHS之技術內容，故證
17 據2及3均已揭露系爭專利請求項8之抗腐蝕金屬層為鎳之
18 技術特徵，即已揭示系爭專利請求項8之附屬技術特徵，
19 則所屬技術領域中具有通常知識者依證據1、2、3之組合
20 即可輕易完成系爭專利請求項8之創作，依證據1、2、3之
21 組合亦足以證明系爭專利請求項8不具進步性。

22 11.原告雖主張證據1為筆記型電腦之應用，散熱器材質一般為
23 銅，證據2、3為桌上型電腦之散熱一般採鍍鎳銅材質之集成
24 式散熱器(IHS)，主要目的係鍍鎳材質可增加焊接性及避
25 免氧化，惟筆記型電腦無前揭需求，所屬技術領域具通常知
26 識者無動機將筆記型電腦中之銅散熱器置換為桌上型電腦鍍
27 鎳的集成式散熱器(IHS)，且受限於筆電空間上限制，無
28 法在證據1中應用結構不同、體積較大且散熱效果較差的集
29 成式散熱器，爭執證據1及證據2、3之間不具結合動機等等
30 。惟查，證據1與系爭專利請求項1之差異僅在於「一鍍在該
31 片體上的抗腐蝕金屬層」、「一液態金屬層，貼合該散熱片

01 之抗腐蝕金屬層」之技術特徵。證據2之影片截圖二（時間
02 戳記00:31）揭示Conductonaut液態金屬之應用範圍為CPU、
03 GPU和遊戲機的冷卻，可與銅或鍍鎳表面接觸的散熱器搭配
04 使用，並無特定僅作桌上型電腦之散熱使用；證據3之結論
05 （Conclusion）中敘明液態金屬可應用鍍鎳的IHS（整合式
06 散熱片）上等內容，是證據2、3已揭示前揭差異技術特徵。
07 又證據1與證據2、3同為使用於電腦散熱技術領域，彼此具
08 有顯著關聯性，且在利用液態金屬塗抹於CPU、GPU與散熱模
09 組接觸面以改善CPU、GPU之散熱效能及目的，於功能或作用
10 上亦具有共通性，此不因該散熱技術所應用之產品為筆記型
11 或桌上型電腦而有所差異，所屬技術領域中具有通常知識者
12 為避免證據1之液態金屬層對散熱模組產生腐蝕，自有合理
13 動機將證據2、3之鍍鎳IHS技術應用至證據1散熱模組之抗腐
14 蝕金屬層貼合面，而為所屬技術領域中具有通常知識者所能
15 輕易完成，故原告之主張並不可採。

16 12.原告另主張證據1、2、3均未揭示系爭專利請求項6之「一立
17 設於該絕緣層旁且圍繞該電子元件的擋板」之技術特徵，亦
18 未揭示系爭專利請求項7之「一立設於該絕緣層上的擋板」
19 之技術特徵，且證據1之保護膠結構與系爭專利擋板結構不
20 同，證據1未有防止金屬液體外溢之功效云云。惟查，證據1
21 之影片截圖五（時間戳記02:38）揭露該保護膠立設三防漆
22 旁，且圍繞該電子元件之技術特徵，已揭示系爭專利請求項
23 6「一立設於該絕緣層旁且圍繞該電子元件的擋板」之技術
24 特徵。又證據1之影片截圖四、五（時間戳記02:06及02:38
25 ）揭露該保護膠貼附於該三防漆層之上方，亦已揭示系爭專
26 利請求項7「一立設於該絕緣層上的擋板」之技術特徵，故
27 原告之主張即不足採。

28 13.至原告雖主張被告遽認系爭專利請求項2未詳盡界定擋板結
29 構，且未參酌系爭專利說明書【0009】段記載，忽略擋板具
30 有阻擋之意涵，而有解釋請求項未以其記載文字為基礎之違
31 法；另依其所提甲證7至11之實驗結果，可證明證據1之保護

01 膠並未具有阻擋功能等等。惟查，系爭專利並未就「擋板」
02 結構有何具體之技術界定，原告主張系爭專利之擋板厚度或
03 結構有別於證據1之保護膠而具有阻擋液態金屬溢出之功效
04 ，顯係引入請求項所未記載之技術特徵，而不當地解釋系爭
05 專利對外公告而客觀表現之專利權範圍，已非可採。又觀諸
06 原告所提甲證7至11之實驗結果雖為：「甲證7、8為系爭專
07 利實驗組的影片及截圖：由甲證8圖1揭示該擋板厚度0.54mm
08 ，蓋上玻璃板（散熱片）實驗組擋板擋住液態金屬而不會向
09 外溢出（本院卷第165頁）；甲證9、10、11為證據1保護膠
10 之對照組的影片及截圖：由甲證11圖1截圖內容揭示該保護
11 膠帶為厚度0.14mm，圖3至5揭示蓋上玻璃板（散熱片）後，
12 液態金屬溢出，保護膠帶不具有阻擋液態金屬功效（本院卷
13 第167、168頁）」。惟專利要件之審查應以系爭專利請求項
14 所載之發明為對象，系爭專利請求項內容既未具體界定擋板
15 之具體結構或高度，已如前述，而甲證7至11之實驗組及對
16 照組均為原告自行臆測之使用情況，與系爭專利請求項1所
17 載內容難謂相同，且依原告所提實驗組之擋板相較對照組之
18 保護膠帶，兩者於厚度特徵上具有明顯差別（0.54mm與0.14
19 mm），是以原告逕依系爭專利所未界定擋板之結構或厚度，
20 主張「擋板」相較於保護膠帶具有阻擋液態金屬之有利功效
21 ，要無可憑。況觀之系爭專利說明書先前技術【0002】段記
22 載液態金屬具有穩定及優異導熱及導電性，鋁易受到液態金
23 屬中鎂金屬的影響而快速腐蝕之內容，是以所屬技術領域中
24 具有通常知識者於應用液態金屬時本即會考量液態金屬溢出
25 產生腐蝕或短路現象，而以擋板或保護膠帶等避免電路接觸
26 產生短路，難謂原處分對於擋板之意涵解釋有何違反論理或
27 經驗法則之情形。

28 七、綜上所述，本件證據1、2、3之組合足以證明系爭專利請求
29 項1至8均不具進步性。從而，被告所為系爭專利請求項1至8
30 舉發成立之原處分，並無違誤，訴願決定予以維持，核無不

01 合。原告仍執前詞請求撤銷原處分及訴願決定，為無理由，
02 應予駁回。

03 八、本件判決基礎已經明確，當事人其餘主張、答辯及訴訟資料
04 經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，並無一一論述的必
05 要。

06 九、結論：本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2
07 條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

08 中 華 民 國 115 年 2 月 26 日

09 智慧財產第一庭

10 審判長法官 汪漢卿

11 法官 曾啓謀

12 法官 吳俊龍

13 以上正本係照原本作成。

14 一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表
15 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內
16 向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提
17 起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按
18 他造人數附繕本）。

19 二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，
20 逕以裁定駁回。

21 三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟
22 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不
23 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。

24

得不委任律師 為訴訟代理人 之情形	所 需 要 件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。

	<ol style="list-style-type: none"> 2. 稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
<p>(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
<p>是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。</p>	

02 中 華 民 國 115 年 3 月 6 日

書記官 蔣淑君